# 微叠层材料及其制备工艺研究进展

易 剑 赫晓东 李 垚

(哈尔滨工业大学复合材料研究所,哈尔滨 150001)

文 摘 着重论述了各种微叠层材料及其制备方法,认为电子束物理气相沉积是制备微叠层材料的有效方法;同时对微叠层材料性能方面的研究也作了相应的论述,并展望了我国今后在这方面的研究方向。 关键词 微叠层材料,制备方法,设备,性能研究

## Research on Microlaminates and Their Preparation

## Yi Jian He XiaoDong Li Yao

(Center for Composite Materials, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001)

**Abstract** Various microlaminates and fabrications are discussed emphatically. Electron beam-physical vapor deposition (EB-PVD) is a better way to fabricate microlaminates. Some research on the property of microlaminates is also considered, and expectation of microlaminates research is also expressed.

Key words Microlaminates, Preparation, Facility, Property investigation

#### 1 前言

长期以来,自然界中一些天然的复合材料如竹、 木、骨、贝壳等具有优异的力学性能;尤其是贝壳珍 珠层,在长期的进化过程中,达到了强、韧的最佳配 合,人们根据其结构原理,在新材料制备时逐步进行 了结构上的仿生。尤其是 1990年 Clegg等人<sup>11</sup>模 仿生物材料结构创造性地制备了 SiC薄片与石墨片 交替叠层结构复合材料以来,通过叠层进行结构强 韧化的方法,已被广泛用于制备高性能的复合材料。

近 20年,随着科学技术的发展,在单独的块体 材料不能满足使用要求的情况下,出于对材料特殊 性能的需要,叠层结构越来越多的被考虑用作各种 各样的特殊材料,如耐高温材料、硬度材料、热障涂 层材料等<sup>[2~14]</sup>。金属间化合物和陶瓷材料具有优 异的高强度及高温性能,可被应用在各个领域。但 它们本身的物理性能,如低温脆性和对环境剥蚀的 敏感性,使它们的应用受到限制。因而,应通过和其他材料进行叠层来补偿这些材料内在性能的不足。 本文针对国内外在微叠层材料方面的研究现状,概 括论述了研究较多的几种微叠层材料体系,及它们的制备工艺和设备。

#### 2 微叠层材料

目前,国内外在微叠层材料方面的研究主要集 中在以下几个领域:金属-金属微叠层材料,金属-陶瓷微叠层材料,金属-金属间化合物微叠层材料, 金属-高分子微叠层材料,陶瓷-陶瓷/高分子微叠 层材料。

## 21 金属-金属微叠层材料

金属 - 金属微叠层材料主要是不同的二元系金 属间化合物,通过固态的非晶反应,形成非晶相。通 常非晶反应主要有两种活化模式:机械活化模式和 热活化模式。机械活化模式主要通过机械合金

收稿日期: 2004 - 06 - 14

2

— 16 —

基金项目:国家自然科学基金(50304007)及哈尔滨工业大学校交叉基金(MD. 2002.03)资助项目 作者简介:易剑,1979年出生,博士研究生,主要从事防护材料及涂层方面的研究工作

化<sup>[13]</sup>来实现;而热活化模式主要通过连续的重复冷 轧结合热扩散<sup>[13~17]</sup>、自蔓燃高温合成<sup>[18]</sup>以及脉冲 激光沉积<sup>[19]</sup>和磁控溅射沉积<sup>[20]</sup>等来实现。

## 22 金属-金属间化合物微叠层材料

金属间化合物具有熔点高、密度低、热传导性高,以及抗高温腐蚀性好等一系列优点,被考虑用作航空工业中的高温结构材料<sup>[21~24]</sup>。金属间化合物由于其晶体构造是长程有序的,所有其晶体的本征脆性涉及两个方面的问题:一是涉及金属间化合物电子结构状态,即除了金属键合以外,其中共价键合所占份量决定了其内禀本征脆性;其二涉及晶型及具有反相畴界的位错滑移机制、晶界脆性问题、环境脆性问题等(主要是氢脆敏感性高)。使金属间化合物在常温下的断裂韧性差,导致它的应用受到很多限制;许多研究者对此投入了大量的研究,进行了各种各样的合金化,包括形成单晶、化合物,以及利用定向凝固形成共晶化合物,但效果都不太理想。最后,发现制备成具有微叠层结构的金属 - 金属间化合物复合材料性能优异。

目前,微叠层材料的研究主要集中在过渡金属 包括 Fe, Ni, Ti和 AI的合金上。当金属间化合物与 金属制成微叠层材料后,可以提高它用作高温结构 材料时的力学性能。金属 - 金属间化合物微叠层材 料的制备方法,目前主要有:激光熔融合成<sup>[25]</sup>、高温 自蔓燃反应<sup>[5, 26]</sup>、电子束物理气相沉积<sup>[27~28]</sup>、以及 溅射沉积<sup>[10]</sup>等方法。如用激光熔融合成 NiA1/Mo 等微叠层材料,高温自蔓燃反应生成 Nb,Al/Nb等 微叠层材料,电子束物理气相沉积 Ni/NiAl等微叠 层材料,以及溅射沉积 Nb/Nb,A1等微叠层材料。 尤其是电子束物理气相沉积技术,不但可以制备出 各种层厚、体积分数以及层组分的金属间化合物复 合材料,而且间隙元素污染程度低,并具备良好的结 构完整性。这些微叠层材料以其优异的性能已逐渐 取代高温合金,作为航空工业中的高温结构材料得 到应用。

## 23 金属 - 陶瓷微叠层材料

陶瓷是一种本质脆性材料,因此提高陶瓷材料 的韧性成为影响陶瓷材料在高技术领域中应用的关 键<sup>[29~31]</sup>。常用的强韧化方法有:变形强化,显微裂 纹增强,金属须、片状纤维或陶瓷纤维增强,以及掺 入一种延性金属相。对于二元系统来说,加入延性 金属相的方法是最好的,它包括三种不同的复合方 式:颗粒增强,纤维增强和叠层增强。研究发现,从 颗粒增强、纤维增强到叠层增强,韧化水平在不断地 提高<sup>[29]</sup>。尤其是叠层强韧化方法,如图 1所示,已 被广泛用于制备高性能的陶瓷基复合材料。



图 1 陶瓷基层状复合材料结构示意<sup>[31]</sup> Fig 1 Schematic drawing of LCMC macrostructure

#### 24 金属 - 高分子微叠层材料

金属 -高分子微叠层材料主要是细纤维 环氧 树脂加强的高分子中间层与金属层叠而成的复合材 料。它用细纤维 /环氧树脂加强的高分子中间层把 铝合金板粘结成一个层,开启了应用拼接思想提高 薄板的最大可用尺寸的先河,结果显示制备的金属 -高分子微叠层材料具有良好的抗损坏性、高的耐 火性和比强度<sup>[32~33]</sup>。

如文献 [34]所述,金属板与纤维增强的复合材 料交替层叠,不但纤维加强的复合材料的特有性能 被基本保留了,而且它与外层金属层的结合也使材 料免受环境的冲击;同时金属层还可提供高的剪切 强度。

## 2 5 陶瓷 - 陶瓷 高分子微叠层材料

陶瓷 - 陶瓷 高分子微叠层材料克服了陶瓷材料的致命弱点——突然性的整体断裂,它的失效是 逐层渐变。层状复合陶瓷材料的载荷 — 位移曲线发 生了极大的改变,如图 2所示<sup>[35]</sup>。



的载荷 —位移曲线



— 17 —

宇航材料工艺 2005年 第 5期

SiC/C层状复合材料的断裂过程不再是普通陶 瓷的一次脆性断裂,而表现出一定的"假塑性"特 征。所制备的材料具有质量轻、断裂韧度高、耐疲劳 和抗热冲击能力强等优点<sup>[36~38]</sup>。

## 3 微叠层材料制备工艺

微叠层复合材料是将陶瓷或金属间化合物等强 性层与金属或有机质韧性层交替层叠,经一定的工 艺加工而成。下面将介绍几种层状复合材料的制备 方法。

## 3.1 流延成型 (Tape Casting)

流延成型又称刮刀成型 (Doctor B lading) 是用 来制备薄片状陶瓷材料最常用的方法,该工艺包括 浆料制备、球磨、成型、干燥、剥离基带等过程。具体 的工艺过程为:将陶瓷粉末与有机溶剂混合制成均 匀稳定的悬浮浆料;当浆料从料斗下部流至基带时, 由刮刀的运动而使浆料形成坯膜,坯膜的厚度由刮 刀的高度控制:坯膜与基带一起送入烘干室,将料中 的溶剂蒸发而有机结合剂将陶瓷颗粒均匀的粘接起 来,形成具有一定强度和柔韧性的坯片;最终可对坯 片进行裁剪、烧结。该工艺的主要优点是可制备大 尺寸的陶瓷薄板,陶瓷基片的厚度易于控制,一般厚 度在 5 ~ 500  $\mu$ m。有利于控制层状材料的结构:缺 点是陶瓷浆料的制备较为复杂,而且有的有机溶剂 具有毒性,难于制备成分复杂的陶瓷薄片。目前已 经利用该工艺与其他工艺相结合制备出各种体系的 层状复合材料。

#### 3.2 轧膜成型 (Dough Rolling)

轧膜成型是一种非常成熟的薄坯成型工艺。一 般分为粗轧和精轧多道工序。具体的过程是先将配 好的粉料经球磨、烘干等工序后得到较为细小的粉 末,再加入一定量的有机结合剂,放入碾片机进行加 热碾轧,使粉料和黏结剂等成分混合均匀,经过一段 时间后有机黏结剂逐渐挥发,制成具有一定厚度的 毛坯,该过程称为粗轧。精轧则是将所得的毛坯再 次送入碾片机,然后调节两轧辊间距,多次折叠、反 复轧炼,最终得到所需尺寸的均匀致密的薄片。该 工艺与流延成型相比,不必制备液体浆料,从而避免 了复杂的浆料制备过程。该工艺制备的坯料具有均 匀致密的优点,但是需粗轧和精轧等多道工序,因而 工艺复杂、效率低,而且所轧的薄片较厚,一般在 - 18 -- 100 µm以上。

## 3.3 注浆成型(Slip Casting)

注浆成型同流延成型类似,也是一种流态成型 的工艺。该工艺也是一种应用非常普遍的陶瓷薄片 成型方法,大多是离心注浆成型。在成型前通过调 节 pH值来调节黏度,使浆料充分流动,与流延成型 不同的是该工艺无需黏结剂,但需要制备陶瓷浓悬 浮体,从而限制了材料的选择。该工艺具有直接形 成层状结构的优点。

## 3.4 轧制扩散 (Forging Diffusion)

轧制扩散工艺是用来制备薄片状金属叠层材料 常用的方法,其工艺流程是:将表面清洁处理后的箔 片交替层叠,放在压力机上在一定的温度下进行轧 制复合,达到一定的变形量之后,把试样放入真空炉 中,在特定的温度下进行扩散处理。该方法的优点 是设备成本低廉,工艺简单易行;缺点是只能用来制 备金属 - 金属微叠层材料,且层间距、层厚比难以控 制。

## 3.5 等离子喷涂 (Plasma Spraying)

等离子喷涂工艺是采用等离子弧发生器 (喷 枪)将通入喷嘴内的气体 (常用 Ar, N<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub> 等气 体)加热和电离,形成高温高速等粒子束流熔化和 雾化金属或非金属材料,使其以高速喷射到经处理 的工件表面上形成涂层的方法。利用该工艺制备出 的叠层状复合材料具有层厚均匀和界面缺陷少等优 点。

#### 3.6 磁控溅射法 (Magnetron Sputtering)

磁控溅射法是目前制备纳米尺寸叠层复合材料 最常用的方法之一。通过改变基片的旋转速度和挡 板的开闭时间等工艺参数,可以制备出所需结构参 数(层间距、层厚比)的叠层状复合材料;该方法制 备出的层状复合材料具有材料体系广、制备过程易 于控制、成膜质量高等优点。但是由于溅射速率低, 难于制备大尺寸的层状复合材料;而且不利于获得 界面清晰、明锐的层状材料。

#### 3.7 脉冲激光沉积 (Pulsed Laser Deposition)

由于成功的制备了 YB a<sub>2</sub> Cu<sub>3</sub> O<sub>7</sub>等高温超导材 料,脉冲激光沉积目前主要用来制备薄膜材料。其 工艺过程是使用一束 10~30 ns的脉冲激光束去蒸 宇航材料工艺 2005年 第 5期 发固体靶材表面,使蒸发物冷凝在基体上,从而可以 制备包括金属、半导体、绝缘体、超导体在内的一系 列物质。该方法简单易行,尤其适合制备那些难熔 的物质;缺点是工艺参数难于控制,而且会产生非热 烧蚀和等离子激发,从而影响物质的沉积过程和沉 积质量。

## 3.8 自蔓燃高温合成 (SHS)

自蔓燃高温合成的工艺过程是先将金属箔片按 一定的方式交替层叠,在真空条件下加热到一定温 度后,施加一定的压力进行反应,反应到一定时间 后,再在一定的温度和压力下进行扩散退火。优点 是工艺简单、生产效率高;缺点是难于合成高致密度 的产品。

#### 3.9 电子束物理气相沉积(EB - PVD) 7

电子束物理气相沉积是以电子束为热源的一种

蒸镀方法,几乎可以蒸发所有的物质。该工艺的具 体工艺过程为:电子束通过磁场或电场聚焦在蒸发 源锭子上,使材料熔化,然后在真空环境下蒸发源材 料的气相原子通常以直线从熔池表面运动到基片表 面沉积成膜。同磁控溅射法相比,电子束物理气相 沉积速率高,特别是大功率电子束物理气相沉积技 术的发展,使制备大尺度叠层复合材料成为可能。 该工艺在制备金属 - 金属、金属 - 陶瓷、金属 - 金属 间化合物等叠层复合材料方面应用前景好。它几乎 可以制备任意体系的多层材料,工艺参数易于选择, 能够精确控制层间距和层厚比。此外,可根据叠层 状复合材料中组元的蒸气压的不同,制备界面成分 梯度变化的层状复合材料。表 1为主要的几种微叠 层材料体系的制备工艺和应用现状。

表 1	主要的人	1.种微叠层材料体系的制备	工艺和应用
<b>1</b> X I			

Tab. 1	<b>Preparation</b>	and application	of differentm	icrolam ina tes	system s
--------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------

微叠层材料体系	制备工艺		
金属 - 金属	机械合金化 ,轧制扩散 , 自蔓燃高温合成 ,脉冲激光沉积 和磁控溅射沉积等	磁光记录介质, 光学记录介质, 磁阻传感器等	
金属 - 金属间化合物	激光熔融合成 ,高温自蔓燃反应 , 电子束物理气相沉积 ,溅射沉积等	高温结构材料等	
金属 - 陶瓷	流延成型,轧膜成型, 注浆成型,等离子喷涂等	高温结构材料等	
金属 - 高分子	流延成型,轧膜成型, 注浆成型,等离子喷涂等	飞行器上的面板等	
陶瓷 - 陶瓷 高分子	流延成型,轧膜成型, 注浆成型,等离子喷涂等	超硬材料,微电子工业中的基板和 航空工业中的热障涂层等	

## 4 微叠层材料性能的研究

由于微叠层材料在工程中的应用最终凭借的还 是它们的强度与韧性等性能,因而有关微叠层材料 本身性能的研究,大部分集中于微叠层材料的变形、 断裂及分层等行为的研究<sup>[7,39~40]</sup>。单层的薄膜和 涂层可通过晶体结构和显微结构来控制它们的性 能,而微叠层材料的性能对界面性能很敏感,因而界 面性能基本上决定了微叠层材料的独特性能。

微叠层材料的断裂过程与层的强度、显微结构、 宇航材料工艺 2005年 第 5期 缺陷以及裂纹尖端的转移过程等有关。通过联合应 用材料的强韧化机理来改善裂纹尖端应力场的形状 和数值,从而可以大幅提高微叠层材料的韧性。同 时,层的形状及微观结构也决定了微叠层材料的变 形机制。

为了尽量减小微叠层材料的原始裂纹缺陷对力 学性能的敏感性,在进行微叠层复合材料结构设计 时,引入了与传统不同的增韧机制,对于像陶瓷和金 属间化合物这样的基体,主要有以下几种增韧机制。

— 19 —

## 4.1 弱夹层裂纹偏转增韧

在设计微叠层复合材料时,常在陶瓷和金属间 化合物这样的高强高硬基体间引入薄的弱夹层。夹 层的要求是弱夹层足以偏转裂纹,强夹层必须有一 定的压缩和剪切性能。

#### 4.2 延性夹层裂纹桥联增韧

延性夹层可以是金属,也可以是延性树脂,以连续层状形式存在。延性层发生较大程度的塑性变形 来消耗、吸收能量,塑性变形区也会导致裂纹尖端屏 蔽,使裂纹钝化,并在裂纹尾部被拉伸和形成桥联, 减小裂纹尖端的应力强度因子,减缓裂纹扩展速率, 阻止裂纹进一步张开,从而改善塑性。

## 4.3 叠加互补增韧

层状陶瓷和金属间化合物材料可使强度在一定 范围内基本与缺陷尺寸无关,但是以牺牲小缺陷时 强度为代价。这种三层结构对从表面缺陷引发的断 裂有效,而对其它情况例如非等轴拉伸,整个材料的 横截面受到同样的应力,这时对强度和韧性没有丝 毫贡献。

## 4.4 界面残余应力增强增韧

利用层状复合材料的基体层与夹层之间热膨胀 系数、收缩率的不匹配或者某层中相变而使层间有 应变差引入残余应力场增强增韧机制。残余应力可 通过 X射线测定,也可以计算出。下面分三层和多 层两种情况进行讨论。

设计三层复合陶瓷时,利用材料线膨胀系数差 异或相变,调节各自层数、层厚,可使表面层产生合 适压应力。因为压缩区的应力区围绕裂纹尖端,抑 制裂纹的产生扩展,所以表面层如有压应力,它的断 裂,疲劳阻抗就会明显的提高,临界裂纹长度减小, 导致强度、韧性提高,表面微硬度也有一定提高。

多层界面应用变"强"裂纹偏转增韧,这种设计 在多层复合材料中引入应力使界面变"强",当裂纹 扩散到界面时,其尖端与应力场作用而偏转,并可能 使裂纹开叉。

#### 5 展望

-20 -

由于微叠层材料的研究起步较晚,只有十多年 的历史,因而对它的研究缺乏系统性。无论是理论 研究,还是材料制备工艺及设备等的研究都还存在 很大的不足,对于微叠层材料这个新兴领域,应该投 入较多的研究力量,开发一些新的设备、工艺,同时 在理论上,给出具有普适性的经验,理论公式。

#### 参考文献

1 Clegg W J, Kendall K, Alford N M. A simple way to make tough ceramics Nature, 1990; 347(10):  $455 \sim 457$ 

2 Was G S, Foecke T. Deformation and fracture in microlaminates Thin Solid Films, 1996; 286: 1~31

3 Wadsworth J, Lesuer D R. Ancient and modem laminated composites-from the great pyramid of gizeh to Y2K Mater Characterization, 2000; 45: 289 ~ 313

4 Lesuer D R, Syn C K, Sherby O D et al Mechanical behavior of laminated metal composites Int Mater Rev., 1996; 41(5): 169~197

5 Shah D M, Anton D L, Pope D P et al In-situ refractory intermetallic-based composites Mater Sci & Eng A, 1995; 192/193: 658~672

6 Jeske T, Schmitz G Influence of the microstructure on the interreaction of Al/Ni investigated by tomographic atom probe Mater Sci & Eng A, 2002; 327: 101 ~ 108

7 Was G S, Foecke T Deformation and fracture in microlaminates Thin Solid Films, 1996; 286:  $1 \sim 31$ 

8 Jalonen P, Tuominen A. The effect of sputtered interface metallic layers on reinforced core laminate making build-up structures Microelectronics Reliability, 2002; 42: 1 075 ~ 1 079

9 B byer D R, Venkateswara Rao K T, Ritchie R O. Lam inated Nb/Nb<sub>3</sub>Al composites: effect of layer thickness on fatigue and fracture behavior Mater Sci & Eng A, 1997; 239/ 240:  $393 \sim 398$ 

10 Banerjee R, Thompson G B, Anderson P M et al Sputter deposited nanocrystalline Ni-25Al alby thin films and Ni/Ni<sub>b</sub>A multilayers Thin Solid Films, 2003; 424: 93 ~ 98

11 Lewis AC, Josell D, Weihs T P. Stability in thin film multilayers and microlaminates: the role of free energy, structure, and orientation at interfaces and grain boundaries Scripta Mater, 2003; 48:1 079 ~ 1 085

12 Amanda K, Petford L. Structural characterization of multiplayer films Thin Sold Films, 1996; 275:  $35 \sim 39$ 

13 Sieber H, Wilde G, Perepezko J H. Thermally activated amorphous phase formation in cold-rolled multilayers of Al-Ni, Al-Ta, Al-Fe and Zr-Cu J. Non-Cryst Solids, 1999; 250 ~252: 611~615

14 Sieber H, Park J S, Weissm ller J et al Structural e-宇航材料工艺 2005年 第 5期 volution and phase formation in cold-rolled aluminum nickel multilayers Acta mater 2001; 49: 1 139 ~ 1 151

15 Himmer T, Nakagawa T, Anzai M. Lamination of metal sheets Computers in Industry, 1999; 39: 27 ~ 33

16 Battezzati L, Pappalepore P, Durbiano F et al Solid state reactions in Al-Ni alternate foils induced by cold rolling and annealing Acta Mater, 1999;  $47(6): 1901 \sim 1914$ 

17 Mengucci P, Majni G, Cristoforo A D et al Structural evolution of Fe-Al multilayers submitted to thermal annealing Thin Solid Films, 2003; 433:  $205 \sim 210$ 

18 Ping Zhu, Li J CM, Liu C T Reaction mechanism of combustion synthesis of NiA1 Mater Sci & Eng A, 2002; 329 ~ 331: 57 ~ 68

19 Lunney J G Pulsed laser deposition metal and metal multiplayer films Appl Surf Sci , 1995; 86: 79 ~ 85.

20 B bbaum K J, Heerden D V, Gavens A J et al Al/Ni formation reactions: characterization of the metastable A  $l_1$  N  $l_2$ phase and analysis of its formation Acta Mater, 2003; 51: 3 871 ~3 884

21 Rawers J C, Alman D E Fracture characteristics of metal-intermetallic laminar composites produced by reaction sintering and hot pressing Compos Sci Technol, 1995; 54: 379 ~ 384

22 Pickard SM, Zhang H, Ghosh A K Interface shear properties and toughness of NiA HMo laminates Acta Mater, 1997; 45 (10): 4 333 ~ 4 350

23 Rohatgi A, Harach D J, Vecchio K S et al Resistance-curve and fracture behavior of Ti-A  $l_{\rm b}$  Ti metallic intermetallic laminate (M L) composites Acta Mater, 2003; 51: 2 933 ~2 957

24 Fox M R, Ghosh A K Structure, strength and fracture resistance of interfaces in NiA1/Mo model laminates Mater Sci & Eng A, 1999; 259: 261~268

25 Maznmder J, Chung H, Yamamoto T et al Nanocrystalline NbA B powders and NbA  $\frac{1}{2}$ -Al multilayers by laser ablation deposition Nano Struct Mater , 1997; 9: 75 ~ 78

26 王华彬,韩杰才,张幸红等.原位合成 Ni/Ni-Al 金属间化合物层板复合材料的组织转变.材料科学与工艺, 1998; 6(3):56~60

27 Movchan B A. EB-PVD technology in the gas turbine industry: present and future JOM, 1996:  $40 \sim 45$ 

28 Li Yao, Zhao Jiupeng , Zeng Gang et al Ni/Ni<sub>3</sub>Al microlaminate composite produced by EB-PVD and the mechanical properties Mater Lett , 2004; 58: 1 629 ~1 633

29 El-Shaer Y, Derby B. Modelling of R-curve behaviour in ceramic-metal laminates Mater Sci & Eng A, 2004;
365: 196~201

30 袁广江,罗永明,陈大明等. SIC基层状复合材料界 面层的选择. 硅酸盐学报,2001; 29(3): 226~231

31 Sherman D. The mechanical behavior of layered brazed metal/ceramic composites Mater Lett , 1998; 33: 255  $\sim 260$ 

32 Vries TJ, Vlot A, Hashagen F. Delamination behavior of spliced fiber metal Laminates Part 1: experimental results Compos Struct, 1999; 46: 131 ~ 145

33 Zheng M ing Huang On a general constitutive description for the inelastic and failure behavior of fibrous laminates-Part I lamina theory. Computers and Structures, 2002; 80: 1 159 ~1 176

34 Afaghi-Khatibi A, Lawcock G, Lin Ye et al On the fracture mechanical behaviour of fibre reinforced metal laminates (FRMLs). Comput Met Appl Mech Eng , 2000; 185: 173 ~190

35 CleggW J. Acta Metall Mater , 1992; 40 (11) : 3 085 ~ 3 093

36 Kokubo T, Kim H M, Miyaji F et al Ceramic metal and ceramic-polymer composites prepared by a biomimetic process Compos Part A, 1999; 30:  $405 \sim 409$ 

37 Xiao B in Hu, B in Yuan Zhao, Ke Ao Hu A novel fabrication of doped C/C composite laminations by aqueous tape casting Acta Mater, 2004; 52:  $467 \sim 73$ 

38 钱晓倩, 葛曼珍, 吴义兵等. 层状复合陶瓷强韧化 机制及其优化设计因素. 无机材料学报, 1999; 14(4): 520 ~526

39 Heerden D V, Gavens A J, Foecke T et al Evaluation of vapor deposited Nb/Nb<sub>5</sub> Si<sub>5</sub> microlaminates Mater Sci & Eng A, 1999; 261:  $212 \sim 216$ 

40 Kim J K, Yu T X. Forming and failure behaviour of coated and sandwiched sheet metals: a review. J. Mater Process Tech , 1997;  $63: 33 \sim 42$ 

(编辑 任涛)

#### 宇航材料工艺 2005年 第 5期